

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2026-042

深南电路股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深南电路	股票代码	002916
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张丽君	谢丹	
办公地址	深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼	深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼	
电话	0755-86095188	0755-86095188	
电子信箱	stock@scc.com.cn	stock@scc.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
--	------	------	-----------------

营业收入（元）	15,296,361,440.43	10,453,454,733.49	46.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,251,458,836.99	1,360,017,775.49	65.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,239,172,474.35	1,265,476,647.45	76.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,501,855,888.16	1,495,526,343.91	0.42%
基本每股收益（元/股）	3.32	2.04	62.75%
稀释每股收益（元/股）	3.32	2.04	62.75%
加权平均净资产收益率	12.43%	9.04%	3.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	40,741,762,317.93	30,582,928,717.03	33.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,030,168,174.10	17,149,430,529.85	5.14%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		71,529	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深天科技控股（深圳）有限公司	国有法人	62.61%	426,489,271	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.71%	18,434,175	0	不适用	0
平安银行股份有限公司－永赢科技智选混合型发起式证券投资基金	其他	1.03%	7,034,753	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金	其他	0.53%	3,583,950	0	不适用	0
富国基金管理有限公司－社保基金 2101 组合	其他	0.47%	3,186,919	0	不适用	0
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-0022L-CT001 深	其他	0.44%	2,967,866	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金	其他	0.33%	2,240,264	0	不适用	0
银华基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	0.30%	2,037,325	0	不适用	0
中航产业投资有限公司	国有法人	0.27%	1,811,929	0	冻结	1,811,929
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	0.25%	1,668,957	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		深天科技控股（深圳）有限公司与中航产业投资有限公司受同一控制方控制，公司未知其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如		无				

有)

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

1、2026 年上半年经营情况

2026 年上半年，全球宏观经济形势复杂多变，地缘冲突导致能源价格飙升，同时黄金、铜、锡等金属价格也在高位波动。IMF（International Monetary Fund，国际货币基金组织）7 月发布的《2026 年世界经济形势与展望》指出，2026 年全球经济增速预计将放缓至 3.0%（2025 年为 3.5%）。尽管宏观环境仍存在较大不确定性，但人工智能产业飞速发展，全球主要云厂商资本支出规模继续增加，带动电子电路产业需求总量保持快速增长。与此同时，受电子产业上游环节供应紧张、物料成本上涨等因素的影响，传统领域需求明显承压，下游需求结构分化进一步加剧。具体到公司所处产业链环节，覆铜板、玻纤布等关键原材料在 AI 算力需求的拉动下呈现供给趋紧与价格加速上行的趋势，部分下游客户为保障稳定供应开始提前铺单。

2026 年上半年，公司紧抓 AI 算力基础设施投资增加及相关产品迭代升级给电子电路行业带来的增长机遇。一方面通过持续强化工艺能力建设，继续加快新客户与关键项目的导入，推动订单增长与产品结构优化。另一方面，通过与上游高效协同稳定供应、深化数字升级提升运营效率，有序推进工厂爬坡释放产能，保障了产出与交付，带动订单与收入的明显增长。报告期内，公司实现营业总收入 152.96 亿元，同比增长 46.33%；归属于上市公司股东的净利润 22.51 亿元，同比增长 65.55%。

（1）印制电路板业务继续把握 AI 算力增长机遇，实现营收利润双增长

报告期内，公司印制电路板业务实现主营业务收入 85.52 亿元，同比增长 36.32%，占公司营业总收入的 55.91%；毛利率 36.85%，同比增加 2.43 个百分点。

通信领域，根据专业机构 Dell'Oro 最新研究，2026 年第一季度全球无线接入网（RAN）市场仅实现低个位数增长；而有线侧受益于全球云服务厂商投资持续增加，高速交换机、光模块需求保持高增长态势。报告期内，公司积极把握上述结构性机遇，凭借领先的技术实力与高效优质的服务能力，推动产品结构持续优化，订单规模大幅增长。

数据中心领域，2026 年上半年全球云服务厂商资本开支规模继续显著增长，驱动 AI 服务器及相关配套产品需求加速释放。报告期内，受益于上述市场机遇，公司相关订单收入突破 20 亿元，同比实现大幅增长，成为 PCB 业务增长关键动力。

汽车领域，上半年鉴于补贴政策收紧、能源成本上涨等多重因素影响，全球汽车销量略有下滑。在整车销量下滑的同时高阶辅助驾驶也在加速成熟，渗透率快速提升。根据佐思汽研统计，今年 4 月国内乘用车标配 L2 级以上功能与自动驾驶域控制器的渗透率分别达 42.7%与 44.5%。报告期内，公司重点把握汽车智能化发展机遇，实现了订单的逆势增长。

报告期内，PCB 业务面临材料供应短缺与产出负荷高企双重压力，公司一方面通过对紧缺物料加大力度备货、拓展多元化供应渠道等举措有力保障了供应稳定；另一方面通过动态优化排产、深化智能制造建设，提升设备综合效率，保障产出维持较高水平。新项目方面，2025 年投产的泰国工厂和南通四期项目整体爬坡顺利，同时本次计划募投的无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目正在进行建设，为后续业务发展提供了产能保障。

（2）封装基板业务继续夯实战略客户合作，带动订单与利润同步增长

报告期内，公司封装基板业务实现主营业务收入 36.67 亿元，同比增长 110.76%，占公司营业总收入的 23.97%；毛利率 31.35%，同比增加 16.20 个百分点。

2026 年上半年，随着 AI 大模型加速向 Agent 应用发展，产业对于计算、存储、电源管理方面的需求加速爆发，进而带动全球半导体行业整体销售额实现显著增长。据 WSTS 统计数据显示，今年 1-5 月全球半导体销售额累计同比增长达 77.6%，其中 5 月单月同比增速高达 104.1%。报告期内，公司封装基板业务充分把握存储、PMIC、FC-BGA 相关市场机遇，实现订单同比快速增长。同时通过前瞻备料、与上游供应链高效协同、联动客户验证新材料等举措，有力保障了高产出和及时交付。

BT 类封装基板，存储产品受益于 AI 应用对内存需求的大幅提升，公司相关订单实现显著增长；FC-CSP 产品通过把握非消费领域机会有效对冲了手机等消费领域需求下滑影响；PMIC 方面受益于客户 AI 电源需求加速放量，订单实现了显著增长；RF 射频类产品结构有所优化，市场开拓取得一定进展。

FC-BGA 类封装基板，公司充分发挥核心技术优势与供应链协同能力，成功推动了高端产品在多个客户处实现规模化量产，带动广州工厂产能加速爬坡。面向下一代先进计算相关基板技术研发进展顺利，为匹配客户中长期产品需求做好技术储备。

（3）电子装联业务进一步深化算力领域布局，推动收入与毛利同步提升

报告期内，公司电子装联业务实现主营业务收入 19.76 亿元，同比增长 33.70%，占公司营业总收入的 12.92%；毛利率 17.30%，同比增加 2.32 个百分点。

2026 年上半年，公司电子装联业务充分把握了数据中心领域需求增长机会，持续深化与战略客户的合作并加快新客户导入，相关项目进入量产阶段。同时，数据中心领域的订单结构明显优化，带动营收和利润明显增长。

能力建设上，公司电子装联业务针对下一代先进计算与互联所需的关键制造及测试能力提前进行布局，为业务增长奠定了坚实基础。

（4）始终坚持技术领先战略，稳步提升高阶产品技术能力

公司长期坚持技术领先战略，以技术发展为第一驱动力，高度重视技术与产品的研发工作，持续加大研发投入规模，不断提升研发和创新能力。报告期内，公司研发投入 8.59 亿元，同比增长 27.81%，占营收比重为 5.61%。公司各项研发项目进展顺利，数据中心、汽车电子、下一代通信相关 PCB 技术研发，FC-BGA 基板产品能力建设，FC-CSP 基板和存储基板技术能力提升等项目均按期稳步推进。报告期内，公司新增授权专利 68 项，新申请 PCT 专利 12 项，多项产品、技术达到国内、国际领先水平。

（5）持续深化碳中和战略，积极加入科学碳目标倡议

在可持续发展领域，公司持续推进“双碳”战略，目前已完成国际温室气体管理标准体系 ISO 14064 认证、并获评深圳市监局颁发的“碳足迹先锋企业”。公司将继续深入推进供应链低碳管理，并推动加入科学碳目标倡议（SBTi），落实科学碳目标相关管理要求。

2、公司及子公司重大事项**（1）2026 年度向特定对象发行股票募集资金项目**

2026 年 6 月 12 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了 2026 年度向特定对象发行股票方案、发行预案等相关议案，公司拟向不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定条件的特定对象发行股票募集资金不超过 488,196.88 万元，扣除发行费用后拟全部用于无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目及补充流动资金。其中，关于投资建设无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目的议案已于 2026 年 4 月 23 日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

2026 年 7 月 9 日，公司披露了《关于 2026 年度向特定对象发行股票获得有权国资监管单位批复的公告》，本次向特定对象发行股票方案获得实际控制人审批通过。

2026 年 8 月 14 日，本次向特定对象发行股票方案经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。

（2）子公司无偿划转事项

报告期内，为实现封装基板业务统筹运营，公司将持有的全资子公司深圳广芯及无锡广芯 100%股权无偿划转至全资子公司广州广芯。